

# 笙科电子股份有限公司

## 部门工作职责

单位		职 掌 概 要
稽核室		协助董事会及经理人检查、评估内部控制制度、管理规章及作业流程管理，并提供分析及建议，以确保内部控制制度得以持续有效运作。
总经理室		1. 公司未来短、中、长期发展之营运目标及计划之拟定及修订。 2. 监督各部室执行营运计划以达成公司营运目标、追求永续经营。 3. 对外公共关系之建立。
新竹设计中心	设计一处 设计三处	1. 公司短期、中、长期研发计划之规画及执行。 2. 新产品之研发与认证、专利技术之建立与申请。
	产品布局一部	1. 基本电路组件(含特殊组件)、新旧产品之布局设计作业。 2. 产品除错/验证工程之协寻作业。
	设计服务部	1. 集成电路代工厂提供之开发工具的管理。 2. 集成电路布局验证程序的问题排除。 3. 集成电路之自动布局及其验证。
台北设计中心	设计二处 设计四处	1. 公司短期、中、长期研发计划之规画及执行。 2. 新产品之研发与认证、专利技术之建立与申请。
	产品布局二部	1. 基本电路组件(含特殊组件)、新旧产品之布局设计作业。 2. 产品除错/验证工程之协寻作业。
业务中心	产品企划部	1. 新产品营销策略之建立及执行。 2. 新产品开发进度之追踪与各部门工作之协调。 3. 新产品基础客户之开发与市场推展。 4. 提供产品线总体市场分析报告-TAM analysis。
	业务一部 业务二部 业务三部	1. 年度销售目标及营业计划之拟定及执行，以达成年度营销目标。 2. 新市场、新客户之开发，以提升市场占有率。 3. 服务客户各项需求及客户诉怨受理与处理。
	深圳代表处 上海代表处	1. 大陆市场及新客户之开发，以提升市场占有率。 2. 服务客户各项需求及客户诉怨受理与处理。
	日本代表处	1. 新市场、新客户之开发，以提升市场占有率。 2. 服务客户各项需求及客户诉怨受理与处理。
管理中心	财务部	1. 统筹公司的财务、会计、税务及经营分析等事宜。 2. 年度预算之编制、汇总及控制。 3. 各项理财活动之调度及运用。 4. 公司股东会、董事会及股务作业相关事宜。
	人事部	1. 行政制度之拟定与实施、各项人事管理作业之规画及执行。 2. 各项教育训练之规画及执行。 3. 各项薪酬与奖惩制度之规画及执行。

生产管理 中心	生产企划部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.拟定年度生产计划及物料需求计划及管理。</li> <li>2.产能规画及管理。</li> <li>3.各项存货之仓储、管理与收发。</li> <li>4.各项成品销货运输作业之管理。</li> <li>5.各项采购策略、采购计划之规画及执行。</li> </ol>
	质量保证部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司标准化、质量系统/活动之维护及推动。</li> <li>2.文件及记录管制作业。</li> <li>3.禁限用物质调查及管理。</li> <li>4.外包厂商之评鉴、质量督导、异常处理。</li> <li>5.半成品及成品之抽检。</li> <li>6.实验室仪器校正管理。</li> <li>7.协助产品开发之相关可靠度实验、失效分析、专利申请。</li> </ol>
	产品测试部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.开发/维护产品相关之测试程序、增加程序功能，使其能提供量产/工程数据。</li> <li>2.提升测试程序之侦错能力，以增进出货质量；提升程序效率，节省测试时间。</li> <li>3.量产产品生产状况之掌握与维护。</li> <li>4.提升工程能力，解决产品相关之技术问题。</li> </ol>
系统应用 中心	韧体设计部 韧体应用部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.协助 IC 设计及企划部门订定新产品数字电路规格。</li> <li>2.验证新开发产品(FPGA/IC)能符合实际应用规格。</li> <li>3.新产品使用及开发平台发展。</li> <li>4.标准化产品软件模块开发。</li> <li>5.配合业务部门进行新产品的推展。</li> <li>6.客户使用产品问题处理及分析。</li> <li>7.产品量产系统开发。</li> </ol>
	硬件应用部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.协助设计 IC 应用之 PCB 布局及基本电路组件(含特殊组件)之布局设计作业。</li> <li>2.设计 Module 之应用及验证，确保新开发产品能符合实际应用规格。</li> <li>3.验证 IC 应用之温度测试及特性分析、产品除错/验证工程之作业。</li> <li>4.客户退货及故障产品之应用分析。</li> <li>5.产品应用状况之掌握与维护。</li> </ol>
	工程支持部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.协助工程师焊接 Module。</li> <li>2.协助工程样品制作。</li> <li>3.提供业务需求的 Module。</li> </ol>
	芯片验证部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.设计 IC 验证之 PCB 布局。</li> <li>2.设计 Module 之应用及验证。</li> <li>3.验证 IC 应用之温度测试及特性分析。</li> <li>4.撰写特定应用参考设计规格书。</li> <li>5.确保新开发产品能符合实际应用规格。</li> </ol>
	软件应用部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.提供客户标准化软件链接库。</li> <li>2.撰写标准化软件链接库使用说明书。</li> <li>3.协助客户顺利整合标准化软件链接库，让客户能自行客制化应用软件。</li> </ol>
	信息服务部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.各项计算机化信息系统软件、硬件之规画及执行。</li> <li>2.各项电信系统及委外工程之协调与管理。</li> <li>3.协助各部门之工作信息科技化。</li> </ol>